



# 电子元器件行业：晶圆厂 WAFERBANK 居于高位 FOUP 供应紧张 静待行业花 开



事件：近日，台积电大客户苹果、AMD、英伟达下调订单，导致部分订单面临延后拉货与毁约。通过与客户进行条件协商，台积电愿意接受大客户换约或长约承诺，而长约承诺使得 waferbank 位居高位。

点评：

半导体下游终端需求萎缩，长约承诺导致 waferbank 位居高位。因下游需求疲软，射频龙头 Qorvo 削减订单支付 1.1 亿美元违约金；台积电三大客户包括苹果、AMD、英伟达下调订单，台积电愿意接受部分客户换约或长约承诺，而长约承诺使得 waferbank 堆放已达新高。Waferbank 堆放需要 FOUP，当前 FOUP 紧张影响到稼动率。据台积电预计，半导体库存于 2022 第 3 季达到高峰，预计 2023 年下半年产能利用率全面回升。

在半导体行业景气下行期，国产替代进程持续推进。据 WSTS 数据，预计今年全球半导体市场达到 5800 亿美元，增速放缓至 4.4%，而 2021 年增速为 26.2%；随着终端市场需求持续减弱，2023 年半导体市场规模预计将同比减少 4.1%至 5565 亿美元。据半导体行业协会数据，2022 年国内 IC 设计销售预计为 5345.7 亿元，同比增长 16.5%，2021 年为 20.1%，预计中国 IC 设计在全球占比进一步提升。

半导体行业景气下行期主要建议关注以下三大行业先行性指标：

①封测厂和晶圆厂产能利用率。随着芯片厂商订单减少，封测厂和晶圆厂感受产品价格传导压力，当前产能利用率已出现松动。

②半导体行业周期底部建议关注 MPW 价格趋势。MPW 制造成本仅为单独进行原型制造成本的 5%-10%，这促进集成电路设计成果转化和新产品的开发。在半导体行业底部阶段，MPW 代工价格降低趋势明显，推动更多芯片设计厂商进行研发和新产品导入。

③在行业周期底部，晶圆厂基于客户销售预期而提前投片订单量 internalPO(internalPurchaseorder)有所提升。

投资建议：我们认为半导体行业接近底部，静待行业花开，从国产替代维度建议重点关注模拟 IC、MCU 和功率半导体行业，受益标的：圣邦股份、中颖电子、兆易创新、士兰微和立昂微。另外我们持续看好半导体上游材料与设备，推荐沪硅产业、江丰电子，受益标的：拓荆科技、芯源微、格林达。

风险提示：(1) 行业景气度下行；(2) 扩产进度不达预期；(3) 中美贸易摩擦加剧。

**预览已结束，完整报告链接和二维码如下：**

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_50697](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_50697)

